



2026年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社デンソー
代 表 者 名 代表取締役社長 林 新之助
(コード番号 6902 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 経理部長 荒井 是
(TEL. 0566-25-5511)

(開示事項の経過) 当社に関する一部報道について

当社は、2026年3月6日付で公表した「本日の一部報道について」のとおり、2025年5月8日に公表したローム株式会社（以下「ローム」といいます。）との半導体事業における戦略的パートナーシップ構築に向けた基本合意に基づき、ロームとの間で、同社株式の取得を含む様々な戦略的な選択肢を検討しております。その後、当社による一連の検討を経て、当社からロームに対し、株式取得に関する提案（以下「本提案」といいます。）を行っております。

当社は、「環境・安心」の理念に沿った社会価値創出と事業成長の両立・最大化を目指しており、社会課題の解決に資する基盤技術の強化の一環として、半導体を重点領域の一つと位置付けております。特にモビリティ領域では、電動化・知能化・社会システム連携などの高度化が急速に進展する中、半導体の付加価値は一層高まっており、当社は、半導体事業への投資を加速し、競争力を着実に向上させてまいりました。

近年では、モビリティに限らず、様々な産業において、半導体がますます重要となる一方で、半導体の技術開発や供給体制が課題となっています。当社は、こうした課題の解決やお客様への提供価値を高めるためには、半導体事業の領域の拡大が欠かせないと考え、今後は、産業機器、民生機器などの領域への展開を加速していく方針です。

そこで、当社は、半導体を巡る競争が激化する近時の環境下において、上記のような課題解決とお客様への提供価値向上を実現するためには、パートナーとの連携が不可欠であると考え、ロームに対して本提案を行うに至りました。当社は、産業機器、民生機器の領域で強みを有するロームと連携し、用途や市場の異なる領域で培われた技術や知見を相互に活かすことによってこそ、半導体事業における幅広い領域での貢献が可能となると考えています。また、当社は、事業領域の拡大を通じて培われる技術や知見により、モビリティ領域のお客様への提供価値向上も

実現できると考えています。

当社は、引き続きロームとの間で、本提案について真摯に検討を進める予定です。今後開示すべき事実を決定した場合には、速やかに公表いたします。

当社は、本提案に限らず、様々な形で第三者との連携の可能性を積極的に検討し、半導体事業においてお客様や幅広い産業へ貢献してまいります。

以上